**コンポジットハイウェイコンソーシアムブース～SAMPE JAPAN先端材料技術展2022**

**パネル展示（10月19日～21日）　申込書　　　　【締切：6月22日（水）】**

※下記にご記入の上、E-mail（chc@mlist.kanazawa-it.ac.jp）またはFAX（076-276-3101）にてお申込みください。

|  |  |
| --- | --- |
| 会社名 |  |
| 担当者 | 所属部署・役職氏名 |
| 連絡先 | 電話番号メールアドレス |
| 展示内容 | 展示概要（※展示内容の概要を記載ください） |
| 製品・技術説明会 | 会場（有料/1万円程度） □　プレゼンを希望する　　　　　　□　希望しないオンライン（無料） 　　　　　　　□　プレゼンを希望する　　　　　　□　希望しない |
| ブースの希望（該当項にチェック） | □　パネル展示のみ　　　　　　　□　パネル展示＋案内パンフ等□　パネル展示＋案内パンフ等＋サンプル品　　（サンプル品のサイズ幅×奥行×高さ：　　　　　　　　　　　　　　　）* 2.0m幅ブースへの出展を検討したい　　　　□　検討しない
 |
| ブース基本構成 | ・バックパネル　幅１,000mm×高さ2,400ｍｍ・テーブル　　　 幅900ｍｍ×奥行495ｍｍ×高さ900ｍｍ・社名板　幅900mm×高さ200mm　※事務局にて手配（記載社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（ロゴ記載は致しません） |
|  |
|

|  |
| --- |
| 問合せ先：CHC事務局（金沢工業大学　ＩＣＣ内）E-mail：chc@mlist.kanazawa-it.ac.jp　担当：渡辺、斉藤、田中、東藤FAX：076-276-3101　TEL：080-5132-5197(渡辺)、076-276-3100(斉藤、田中、東藤) |

 |
| JEC World 2023への出展に関するアンケート（2023年4月25日～27日　パリにて開催）　 | CHCはJEC Worldでの共同出展を検討しています。事前意識調査アンケートにご協力お願いします。出展料は100万円程度/社 を予定。※場所・装飾代込み。旅費は別途要。　（こちらはあくまでもアンケートであり、申込ではありません。） □　出展を希望する　　　　□　希望しない　　　　□　検討したい |